



2026年7月31日

各 位

会 社 名 株式会社岡本工作機械製作所
代 表 者 代表取締役社長執行役員 伊藤 暁
(コード番号6125 東証 スタンダード市場)
問合せ先 取締役常務執行役員
管理本部長 高橋 正弥
(TEL. 027-385-5800)

第三者割当増資における調達資金の資金使途および支出予定時期の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年5月22日付「資本業務提携、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」及び2026年6月12日付および6月26日付「第三者割当増資における調達資金の資金使途および支出予定時期の一部変更に関するお知らせ」において開示いたしました第三者割当増資（以下「第三者割当」という。）に係る調達資金の資金使途及び支出予定時期について、一部変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、2026年6月26日付「第三者割当増資における調達資金の資金使途および支出予定時期の一部変更に関するお知らせ」において、第三者割当により調達した資金のうち、下記⑥「今後の事業環境や当社グループの成長戦略を踏まえた資金活用（詳細未定）」については、具体的な資金使途及び支出予定時期は未定である旨を開示しておりました。

その後、当社グループを取り巻く事業環境及び今後の成長戦略について検討を重ねた結果、半導体関連装置事業における競争力強化及び市場開拓を加速することが、中長期的な企業価値向上に資するものと判断いたしました。

このため、下記⑥に係る資金の一部について、台湾におけるテスト加工等を目的としたデモ施設および半導体関連装置における次世代半導体材料向け新規加工装置の研究開発投資に充当することとし、当該資金使途に係る金額及び支出予定時期を決定いたしました。

なお台湾におけるデモ施設につきましては、世界有数の半導体産業集積地である台湾市場において、顧客との接点を強化し、市場ニーズに迅速に対応できる体制を構築することを目的として設立するものであります。台湾半導体市場は今後も成長が期待される市場であり、同デモ施設を活用することで、お客様への提案力及び営業活動の強化を図ってまいります。（⑥-1）

また、半導体関連装置における次世代半導体材料向け新規加工装置の研究開発投資につきましては、当社半導体関連装置事業において、これまで製造・販売実績のない新たな加工領域を対象とする装置の開発に取り組むものであり、中長期的な製品ラインアップの拡充及び競争力強化を目的としております。（⑥-2）

一方、下記⑥に係る資金の残額につきましては、引き続き今後の事業環境や当社グループの成長戦略を踏まえた資金活用について検討を継続しており、現時点において具体的な資金使途及び支出予定時期は未定であります。（⑥-3）

今後、具体的な内容が決定した場合には、速やかに開示いたします。

2. 変更の内容

当社は、2026年6月26日付「第三者割当増資における調達資金の資金使途および支出予定時期の一部変更に関するお知らせ」において、第三者割当により調達した資金の資金使途、金額および支出予定時期の一部変更を開示しており、その時点において下記⑥に係る金額および支出予定時期については未定としておりました。

今般、下記⑥に係る資金の一部について、具体的な資金使途、金額および支出予定時期を決定したことに伴い、前回開示時点の内容から下記のとおり変更いたします。（なお、変更箇所は下線で示しております。）

（前回開示時点）

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 半導体関連装置及び工作機械に関連した技術開発棟の新設、ショールームの刷新のための設備資金	1,731	2024年8月～2027年3月
② 次世代機種の新規開発に向けた研究開発投資	1,500	2024年8月～2026年3月 (充当済)
③ 半導体関連装置及び工作機械に関連した高い付加価値を継続的に提供するための自動倉庫棟の建設資金	1,606	2024年6月～2026年2月 (充当済)
④ 大和工機株式会社における半導体関連装置の生産能力向上に向けた設備更新・新規設備投資	—	—
⑤ ①の技術開発棟のラボ機能の向上および人財戦略の拠点としての活用のための設備資金および改修工事等資金	800	2026年7月～2028年3月
⑥ 今後の事業環境や当社グループの成長戦略を踏まえた資金活用（詳細未定）	3,969	未定

（今回変更後）

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 半導体関連装置及び工作機械に関連した技術開発棟の新設、ショールームの刷新のための設備資金	1,731	2024年8月～2027年3月
② 次世代機種の新規開発に向けた研究開発投資	1,500	2024年8月～2026年3月 (充当済)
③ 半導体関連装置及び工作機械に関連した高い付加価値を継続的に提供するための自動倉庫棟の建設資金	1,606	2024年6月～2026年2月 (充当済)
④ 大和工機株式会社における半導体関連装置の生産能力向上に向けた設備更新・新規設備投資	—	—
⑤ ①の技術開発棟のラボ機能の向上および人財戦略の拠点としての活用のための設備資金および改修工事等資金	800	2026年7月～2028年3月
<u>⑥-1 台湾におけるデモ施設設立</u>	<u>550</u>	<u>2026年8月～2029年12月</u>
<u>⑥-2 半導体関連装置における次世代半導体材料向け新規加工装置の研究開発投資</u>	<u>400</u>	<u>2026年8月～2029年12月</u>
<u>⑥-3 今後の事業環境や当社グループの成長戦略を踏まえた資金活用（詳細未定）</u>	<u>3,019</u>	未定

3. 業績への影響

資金使途の金額および支出予定時期の変更による当期業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、開示の必要性が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以 上